

グローバル COE ミニセミナー

「Present Status and Prospect of Compound Semiconductor HBT Technology」

セミナーレポート

講師：Dr. Noren Pan (CEO and President of MicroLink Devices, Inc.)

日時：2007年10月25日 16:30-18:00

場所：福井大学 ベンチャービジネスラボラトリ 5階 会議室

概要：

第3世代携帯電話端末や超高速計測器などの主要部品として、化合物半導体ヘテロ接合を用いた HBT (Heterojunction Bipolar Transistor) が広く活用されている。講演者の Noren Pan 氏はイリノイ大学を卒業後 (1988 Ph.D 取得)、Raytheon 社、Kopin 社での研究所勤務を経て、2000年に MicroLink 社の CEO となり、今日に至っている。この間、Pan 氏は一貫して化合物ヘテロ接合デバイス、特に HBT の結晶成長、プロセス技術、デバイス評価の研究に従事してきた。今回のセミナーでは、各種化合物半導体の特徴および電子デバイスの種類と特徴の説明から始め、デバイス開発の最先端、信頼性確保のポイント、将来技術の展望などについて講演をいただいた。世界視野から見た化合物半導体デバイスビジネスの展望についても紹介いただいた。(言語：英語)

以上